

//hyu.wiki/%EB%B0%98%EB%8F%84%EC%B2%B4_%EB%B6%80%ED%92%88_%EC%9E%A5%EB%B9%84%EA%B8%B0%EC%88%A0_%EC%A0%84%EB%AC%B8%EC%9D%B8%EB%A0%A5_%EC%96%91%EC%84%B1%EC%82%AC%EC%97%85

반도체 부품 장비기술 전문인력 양성사업

반도체 부품 장비기술 전문인력 양성사업은 산업통상자원부와 한국반도체산업협회가 주관하는 산업혁신인재성장 지원(R&D)사업의 일환으로, 산업 밀착형 우수 인재 양성과 반도체 전문인력 부족 문제 해소에 기여하고자 마련된 사업이다.

소개

- 컨소시엄 참여 대학 : 강남대, 서울과기대, 성균관대, 안동대, 인하대, 충북대, **한양대**
- 목표: 글로벌 경쟁력 확보를 위한 실무 중심형 반도체 소재부품 장비 분야 및 패키지&테스트 분야의 전문인력 양성
- 지원사항
 1. 서울과기대, 2021년 3월부터 2024년 2월까지 3년간 총 6.1억원의 사업비를 지원받아
 2. 석사과정 대학원생 대상 산학협력 프로젝트 수행, 반도체산업협회 주관 단기실습프로그램 참여, 현장 실습, 장학금 지원, 학부생 단기프로그램 등 실시 예정